

Lagenaufbau

| Ebene | Komponente | Dicke (mm) | Cu (my) | Typ |
|--------|------------|------------|---------|------|
| 1 | Cu+galv.Cu | | 18+25 | |
| | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| 2 | Cu | 0.51 | 35 | |
| | Tr-Lam | | | |
| | Cu | | | |
| 3 | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Cu | 0.51 | 35 | |
| Tr-Lam | | | | |
| Cu | | | | |
| 4 | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Cu | 0.51 | 35 | |
| Tr-Lam | | | | |
| Cu | | | | |
| 5 | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Cu | 0.51 | 35 | |
| Tr-Lam | | | | |
| Cu | | | | |
| 6 | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Cu | 0.51 | 35 | |
| Tr-Lam | | | | |
| Cu | | | | |
| 7 | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Prepreg | 0.068 | | 1080 |
| | Cu+galv.Cu | | 18+25 | |

| | | |
|---|------|---------|
| Presslingsdicke * | 2,31 | +/- 10% |
| Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske * | 2,42 | +/- 10% |

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Durchgangslöcher [A] (Vias) | End-Ø | ≥ 300 µm |
| | Viapad-Ø | ≥ 600 µm |
| Leiterbild Außenlagen | Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer | ≥ 80 µm |
| | Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer | ≥ 100 µm |
| | Standard | |
| | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 100 µm |
| | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 120 µm |
| Leiterbild Innenlagen | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 130 µm |
| | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 175 µm |
| | Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer | ≥ 190 µm |
| | Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer | ≥ 240 µm |
| | Standard | |
| Leiterbild Innenlagen | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 65 µm |
| | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 80 µm |
| Standard | | |
| Leiterbild Innenlagen | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 85 µm |
| | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 100 µm |